

# 铌酸锂晶片精密切割镀膜晶圆激光打孔刻槽改小加工支持定制

产品名称	铌酸锂晶片精密切割镀膜晶圆激光打孔刻槽改小加工支持定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

## 产品详情

传统硅片切割方式是机械切割，速度慢、断面平整性差、碎片多、不环保。硅是一种脆性材料，机械切割极易使边缘产生破裂，造成硅表面弹性应变区、位错网络区和碎晶区的组成层损伤，甚至可能造成隐形裂纹，影响电性参数等危害。激光切割技术具有无接触、无机械应力、切缝宽度小、断面平整光滑、精度高、速度快、性能稳定等优势；不会损伤硅片结构，电性参数要优于传统的机械切割方式，可应用于大面积电池片进行划线切割，做到\*\*控制切割精度及厚度，进一步减少切割碎屑，提高电池利用率。

太阳能行业中，光伏电池的生产中涉及了大规模的硅晶片的切割，目前，仍大量使用线切割的方式，但激光切割的应用已越来越多。激光切割与传统的机械切割硅片相比，有比较大的优势，如：切割精度高、切缝窄、质量高、成品率高，不会造成材料的浪费并且切割面光滑；作为一种非接触式的切割方式，不会对产品造成形变或者产生脏污，是一种绿色环保的加工手段；\*主要的一点是且切割效率相比传统切割大大提高。